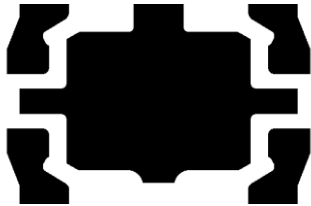






|  |  |
|--|--|
| <b>Title of Change:</b>                          | SOT-23 5L Leadframe Design Change  |
| <b>Proposed First Ship date:</b>                 | 22 May 2021 or earlier if approved by customer   |
| <b>Contact Information:</b>                      | Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:Joseph.Mendoza@onsemi.com">Joseph.Mendoza@onsemi.com</a>   |
| <b>PCN Samples Contact:</b>                      | Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">&lt;PCN.samples@onsemi.com&gt;</a> .<br>Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.<br>Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.   |
| <b>Type of Notification:</b>                     | This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">&lt;PCN.Support@onsemi.com&gt;</a> |
| <b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b> | Affected products will be identified with date code.   |
| <b>Change Category:</b>                          | Assembly Change  |
| <b>Change Sub-Category(s):</b>                   | Change in leadframe design   |
| <b>Sites Affected:</b>                           |  |
| <b>ON Semiconductor Sites</b>                    | <b>External Foundry/Subcon Sites</b>   |
| ON Semiconductor Cebu, Philippines               | None   |

**Description and Purpose:**

Change in Die Attach pad (DAP) and leadpost dimensions to consolidate two similarly designed leadframes into one design.

|           | Before Change Description   | After Change Description   |
|-----------|---|--|
| LeadFrame | <p>Affected parts: FAN5331SX, FAN2558S38X, FAN2558S35X, FAN2558S33X, FAN2558S25X, FAN2558S18X, FAN2558S15X, FAN2558S13X, FAN2558S12X, FAN2558S10X</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• DAP Size: 1.524x1.143mm</li> <li>• Leadpost Size: 0.343x0.203mm</li> </ul> | <p>Affected parts: All</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• DAP Size: 1.676x1.219mm</li> <li>• Leadpost Size: 0.295x0.203mm</li> </ul> |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>Affected Parts: FIN1001M5X, FIN1002M5X,<br/>FAN3111ESX, FAN3111CSX</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• DAP Size: 1.321x1.092mm</li> <li>• Leadpost Size: 0.445x0.203mm</li> </ul> |  |
|--|---|--|

There is no product marking change as a result of this change.

**Qualification Plan:**

**QV DEVICE NAME:** FAN2558S33X, FIN1002M5X

**RMS:** F69224, F73717, F69223, F69786

**PACKAGE:** SOT-23 5L

| Test  | Specification          | Condition   | Interval  |
|-------|------------------------|---|-----------|
| HTSL  | JESD22-A103            | Temp = 150°C  | 1,008 hrs |
| TC    | JESD22-A104            | Temp = -65°C to +150°C  | 1,000 cyc |
| HAST  | JESD22-A110            | Temp = 130°C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 100% of rated V or 100V max | 96 hrs    |
| UHAST | JESD22-A118            | Temp = 130°C, RH=85%, ~18.8 psig, Unbiased                            | 96 hrs    |
| PC    | J-STD-020, JESD22-A113 | MSL 1 @ 260°C   | -         |

Estimated date for qualification completion: 22 January 2021

**List of Affected Parts:**

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

| Part Number | Qualification Vehicle |
|-------------|-----------------------|
| FIN1001M5X  | FIN1002M5X            |
| FIN1002M5X  | FIN1002M5X            |
| FAN3111ESX  | FIN1002M5X            |
| FAN3111CSX  | FIN1002M5X            |
| FAN5331SX   | FAN2558S33X           |
| FAN2558S38X | FAN2558S33X           |
| FAN2558S35X | FAN2558S33X           |



# Initial Product/Process Change Notification

Document #:IPCN23511X

Issue Date:11 Nov 2020

|             |             |
|-------------|-------------|
| FAN2558S33X | FAN2558S33X |
| FAN2558S25X | FAN2558S33X |
| FAN2558S18X | FAN2558S33X |
| FAN2558S15X | FAN2558S33X |
| FAN2558S13X | FAN2558S33X |
| FAN2558S12X | FAN2558S33X |
| FAN2558S10X | FAN2558S33X |

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23511X

発行日: 11 Nov 2020

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| 変更件名:                              | SOT-23 5L リードフレーム設計の変更   |   |
| 初回出荷予定日:                           | 22 May 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前  |   |
| 連絡先情報:                             | 現地のオン・セミコンダクター営業所または < <a href="mailto:Joseph.Mendoza@onsemi.com">Joseph.Mendoza@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。   |   |
| サンプル:                              | 現地のオン・セミコンダクター営業所または < <a href="mailto:PCN.Samples@onsemi.com">PCN.Samples@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。<br>サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。<br>サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。   |   |
| 通知種別:                              | これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。<br>最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。 |   |
| 部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:              | 影響を受ける製品は日付コードで識別されます。   |   |
| 変更カテゴリ:                            | 組立の変更  |   |
| 変更サブカテゴリ:                          | リードフレーム設計の変更   |   |
| 影響を受ける拠点:                          |  |   |
| 外部製造工場 / 下請業者拠点:                   | 外部製造工場 / 下請業者拠点:   |   |
| ON Semiconductor Cebu, Philippines | なし   |   |
| 説明および目的:                           | ダイ接着パッド (DAP) とリードポストの寸法を変更し、類似した設計である 2 種類のリードフレームを 1 種類に統合します。   |   |
|                                    | 変更前の表記   | 変更後の表記  |
| リードフレーム                            | <p>影響を受ける製品: FAN5331SX, FAN2558S38X, FAN2558S35X, FAN2558S33X, FAN2558S25X, FAN2558S18X, FAN2558S15X, FAN2558S13X, FAN2558S12X, FAN2558S10X</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>DAP サイズ: 1.524x1.143mm</li> <li>リードポストサイズ: 0.343x0.203mm</li> </ul>     | <p>影響を受ける製品: すべて</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>DAP サイズ: 1.676x1.219mm</li> <li>リードポストサイズ: 0.295x0.203mm</li> </ul> |



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23511X

発行日: 11 Nov 2020

影響を受ける製品: FIN1001M5X, FIN1002M5X,  
FAN3111ESX, FAN3111CSX



- DAP サイズ: 1.321x1.092mm
- リードポストサイズ: 0.445x0.203mm

今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。

## 認定計画:

デバイス名 : FAN2558S33X, FIN1002M5X  
RMS : F69224, F73717, F69223, F69786  
パッケージ : SOT-23 5L

| テスト   | 規格                     | 条件  | 間隔        |
|-------|------------------------|---|-----------|
| HTSL  | JESD22-A103            | Temp = 150°C  | 1,008 hrs |
| TC    | JESD22-A104            | Temp = -65°C to +150°C  | 1,000 cyc |
| HAST  | JESD22-A110            | Temp = 130°C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 100% of rated V or 100V max | 96 hrs    |
| UHAST | JESD22-A118            | Temp = 130°C, RH=85%, ~18.8 psig, Unbiased                            | 96 hrs    |
| PC    | J-STD-020, JESD22-A113 | MSL 1 @ 260°C   | -         |

認定完了予定日 : 22 January 2021

## 影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

| 部品番号        | 認定試験用ピークル   |
|-------------|-------------|
| FIN1001M5X  | FIN1002M5X  |
| FIN1002M5X  | FIN1002M5X  |
| FAN3111ESX  | FIN1002M5X  |
| FAN3111CSX  | FIN1002M5X  |
| FAN5331SX   | FAN2558S33X |
| FAN2558S38X | FAN2558S33X |



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23511X

発行日: 11 Nov 2020

|             |             |
|-------------|-------------|
| FAN2558S35X | FAN2558S33X |
| FAN2558S33X | FAN2558S33X |
| FAN2558S25X | FAN2558S33X |
| FAN2558S18X | FAN2558S33X |
| FAN2558S15X | FAN2558S33X |
| FAN2558S13X | FAN2558S33X |
| FAN2558S12X | FAN2558S33X |
| FAN2558S10X | FAN2558S33X |